



米国半導体、ポストPCに照準

半導体の応用分野で最も業が多い。そうした中、大(三〇〜四〇%)のP Cが、先進国で、高い普及率となったことで、伸びが頭打ちとなり「キチナーアプリケーションがな」と嘆く米国半導体企

業が多い。そうした中、ポストPC(PC後)分野として、デジタルカメラやゲーム機、携帯電話などの新たな消費者用機器(デジタル家電)向けへ事業戦略を傾斜する米

国半導体企業が増えている。メモリー産業が、アジアほかに盛んでない同国では、組み込みMPU/DSPや、ASIC/PPGAなどロジックICコアによるSOC強化

比二〇%増の勢いで伸びている(幹部)。DSPとアナログ技術を中核とするデジタル・オーディオ、DVD機、デジタルアンプ、デジタルカメラ、プリンター機などを

のHDTV市場を五七億ドル(〇二年四八億ドル)、DVDは二六億ドル(〇二年は二五億ドル)、MP3は〇二年比二七%の売り上げ増、モバイルビデオとカーナビ

供給するTensilica社(カリフォルニア州)は、最近ARMCやMIPS社に次ぐ勢いと言われ、最新の「Xtensav」コアを、日本

同じくMPUコアを供給するARC社(カリフォルニア州)は、モバイル機とデジタル家電間で、PCを使わずに高速通信を可能にするUSB二・〇対応のOTG(On The Go)高速コントローラーを製品化(〇二年六月)、デジタルカメラ関連での成長が活発

年は二〇億ドル(Doug・Andrew氏)。アジア地域のデジタル家電による市場底上げへの期待が強い。

一チップでは無線アクセスポイントを、異なる無線LAN通信プロトコルで同時に支援可能。

Intel社は、PC用途とは言え、モバイルやWireless型、無線LANを強化している。携帯電話用も開始した。

高速・低消費電力を開発

が目立つ。

TI社はデジタル情報家電向けのトータルソリューションを提供する

事業開発分野としている。Motorola社はWireless(無線)技術の通信基盤および端末向け半導体を強化、第三世代通信のほか、ホームゲートウェイ向けなどに「GHz・六四ビットPCIに対応する新プロセッサ」を投入している。

は〇三年に二〇%成長、ビデオ市場は二〇五億ドル(〇二年比横ばい)(Jeffrey・Joseph副社長)とデジタル家電の高成長を予測。

のNTTエレクトロニクス(株)が使い、双方向ビデオ通信用のMPEG2 CODEC・LSIの開発を始めた。

ア州)は、マルチプロトコル無線LAN向けを供給開始した(〇二年二月)。

ASICでダントツ首位のIBMは、〇・〇七μm設計、七二〇万ゲートを支援するASICを供給、WAN、通信基地局、サーバー市場を強化している。

専門組織「DCES」(Digital Consumer Electronics Solution)カンパニーを発足した(〇二年)。同カンパニーは日本に本部を設置、約三〇〇人の技術者を持つ。本社ダラスと、インドにも一〇〇人の技術者を配置。同カンパニーの売の上げは「一八〇%以上を日本企業が占め、前年

米消費者機器協会(略称CEA/Consumer Electronics Association)は「〇三年

のCAGRで一〇%の伸び率。〇三年は二〇%増の一七〇〇億ドル、〇四

社(カリフォルニア州)は、レーザープリンター機や消費者用機器向けにMIPS基盤のMPU・IPコアを供給開始した(三月)。これは三五〇

ASIC/PLD分野で五位に浮上したXilinx社は、通信基地局や携帯電話向けを強めている。

無線LANやデジタル家電